

105 get scanned

DOCUMENT 1/1  
DOCUMENT NUMBER  
@: unavailable

1. JP,54-011250,B(1979)

①日本特許庁 (JP) ②特許出願公査  
③特許公報 (B2) ④昭54-11250  
⑤Int.Cl.3 B22E29 ⑥日本分類 12B11 ⑦内訳書付 ⑧公査登録番号 10545(1979)8月14日  
B22K15/00 6370-1E  
発明の数 1  
(2頁)

## ④電子盤加工法

⑨ 利 習50-6715  
⑩ 申 願 44-7082  
⑪ 出 版 44(1971)8月16日  
公 査 47-29239  
⑫ 例 用 47(1972)11月4日  
⑬ 例 用 著者 佐々木裕  
東京都渋谷区の33の1日本電  
気株式会社内  
⑭ 例 用 人 日本電気株式会社  
東京都渋谷区の33の1  
⑮ 例 用 人 介護士 内原智  
⑯ 例 用 文 獣  
特 公 田89-27322

## ⑩特許請求の範囲

1. 電子盤を用いて突き合せ凹部を行なう際、  
被接合部の片方の端材または両方の端材に突出部  
を作り、前記片方の端部の突出部または両端材の  
突出部の両面を斜面を削して電子盤を接合して好  
接合し、かかる接合部を削除することを特徴  
とする電子盤加工法。  
本発明は、電子盤を用いて接合を行なう際の電  
子盤加工法に関するものである。  
通常、電子盤を用いて突き合せ凹部を行なう  
には、第1図に示すように、被接合部の1と2との  
端合間に直接電子盤3を接合して、被接合する電  
子盤加工法を用いる。

然しながら、上記方法を用いる限り、被接合物  
1、2の材質とか接着剤とかの強度とか接  
合ビードの有無等により、接合部にしばしば  
アンダーカットを生じる。たとえば、チタンとか  
マグネシウム合金等の材質はアンダーカットを  
生じ易いし、また被接合の密着度が良くないと  
か接合ビードを多く形成させる時にもアンダーカ

フトを生じ易い。

このアンダーカットが被接合部に残されたままで、被接合部は接合部の正確さを保てるならば、应力  
集中による被接合部の空氣の原因となる事が考え  
られる。従つて、被接合の端のアンダーカットは是  
れと大きくなればならないことは眞切のことと  
ある。

本発明の目的にこのアンダーカットを防止し、  
強度的密度を十分持った電子盤加工法を提供する  
ものである。

本発明によれば、電子盤を用いて突き合せ凹部  
を行なう際、被接合部の片方の端材または両方  
の端材に突出部を作り、この突出部を通して接合  
することを特徴とする電子盤加工法を得る。

15. 以下図により本発明を詳細説明する。

第2図に、本発明による電子盤加工法の一実施  
形を示す。これは2回の接合操作で、6を電子盤  
を用いて突き合せ凹部を行なう際、これらのも  
らから一方(第2回では8)に突出部を作り、  
20. 2接合をねらう。

この状態にて前記突出部を通して電子盤6を接  
合面に接合し接合を行なう。ただし、この場合、  
被接合部は、突出部により固定されているため、あら  
かじめ突出部表面の電子盤接合位置にマジックテープを  
25. 入れておくとか、兩接合が電子盤接合位置と一致  
するよう被接合部をセッティングしておくことが必要  
となる。

さて、第2図に示された加工法で接合を行え、  
アンダーカットを出した被接合部を、機械的に初期  
状態すれば良好な被接合部が得られることになる。

また、この突出部の大きさは、被接合物の強度、  
対角、被接合部の強度、形成する接合ビードの大  
きさ等によって決定される。

以上で、本発明の装置的説明を終るが、実用的  
な例としての電子盤加工法が簡易な形态もある。  
第3図に示した実験例は2倍の被接合物8、9

-41-

BACK NEXT

MENU SEARCH

HELP

JP,54-011250,B STANDARD ZOOM-UP ROTATION No Rotation

RELOAD PREVIOUS PAGE

NEXT PAGE

DOCUMENT 1/1  
DOCUMENT NUMBER  
@: unavailable

1. JP,54-011250,B(1979)

(2) 特公 昭54-11250

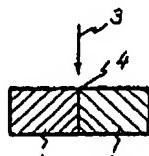
電子部を用いて突き合わせ研削を行なう際に、それを用いて外側面を作り、この突出部を通じて電子部10を内側に研削を行なう。このような形状の突出部にすれば最後の切削加工は、図2図のそれに比べて容易になる。

次に、図4図に示した突き出た円筒形の状態は図1図に示す内凹部たるみた12を有する場合に用いる電子部の形状であり、電子部を用いて突き合わせ研削を行なう際に、被削材たるみた12は円筒形の被削部11の内径より外側に突出部10の突出部を示し、8, 9は被削部、7, 10, 11は電子部、12は円筒形の被削部や、13は被削部たるみたを示す。

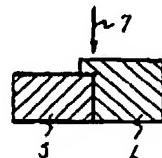
3 有効な防錆方法となる効果がある。

防錆の簡単な説明

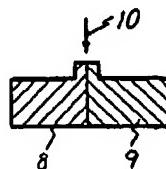
図1図は従来の電子部加工台を示し、1, 2は被削部、3は電子部、4は固定部である。図2図、図3図、図4図は本発明による電子部加工法は円筒形の被削部11の内径より外側に突出部10の突出部を示し、8, 9は被削部、7, 10, 11は電子部、12は円筒形の被削部や、13は被削部たるみたを示す。



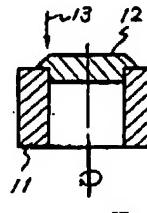
ガ1図



ガ2図



ガ3図



ガ4図

-42-

BACK NEXT

MENU SEARCH

HELP

JP,54-011250,B

© STANDARD  ZOOM-UP ROTATION  No Rotation

RELOAD

PREVIOUS PAGE

NEXT PAGE